

天风证券股份有限公司
关于博通集成电路（上海）股份有限公司
部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期
的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“博通集成”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况及项目结项情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354 号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，募集资金人民币 646,058,293.92 元，募集资金净额为 603,076,507.38 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 20 日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	拟使用募集资金	累计投入金额	投入进度
1	标准协议无线互联产品技术升级项目	10,899.97	11,067.10	101.53%
2	智能家居入口产品研发及产业化项目	11,361.30	11,611.81	102.20%

3	国标 ETC 产品技术升级项目	8,711.08	8,967.17	102.94%
4	卫星定位产品研发及产业化项目	4,898.12	5,139.66	104.93%
5	研发中心建设项目	24,437.19	16,469.67	67.40%
合计		60,307.66	53,255.41	88.31%

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》，“标准协议无线互联产品技术升级项目”、“智能家居入口产品研发及产业化项目”、“国标 ETC 产品技术升级项目”、“卫星定位产品研发及产业化项目”已经达到预定可使用状态，予以结项并将节余募集资金合计人民币 3,053.75 元转入公司 IPO 募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801200000984 户中，用于“研发中心建设项目”。

3、本次拟结项募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 20 日，公司首次公开发行募集资金投资项目之一“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，该项目拟使用募集资金投资金额 24,437.19 万元，已投入募集资金 16,469.67 万元，实际节余募集资金 10,803.41 万元（包含募集资金现金管理及账户存储产生的利息收入等 2,835.89 万元）。公司拟将上述节余资金（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）投入至新增募投项目“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”。本次节余募集资金金额占公司 2019 年首次公开发行股票募集资金净额的比例为 17.91%。

（二）2020 年非公开发行股票募集资金情况及部分项目变更、延期情况

1、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212 号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象发行 A 股股票共 11,711,432 股，每股发行价格为 65.00 元，募集资金 761,243,080.00 元，募集资金净额为 744,246,764.69 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA16102 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2020 年非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 20 日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	拟使用募集资金	累计投入金额	投入进度
1	智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	64,424.68	35,649.48	55.34%
2	补充流动资金	10,000.00	9,998.67	99.99%
合计		74,424.68	45,648.15	61.33%

截至 2025 年 6 月 20 日，公司非公开发行募集资金实际剩余资金 34,333.40 万元（包含募集资金存储及现金管理产生利息收入累计 5,556.87 万元）。

3、拟变更部分募集资金投资项目的情况

为提高公司募集资金使用效率，在充分考虑公司战略重点方向及市场环境变化因素的基础上，公司拟调整“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”的投资总额和内部投资结构并调减其募集资金投资金额 21,042.13 万元，调减金额投入至新增项目“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”，具体如下：

单位：万元

变更前				变更后			
项目名称	总投资金额	拟使用募集资金投入金额	募集资金已投入金额	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金投入金额	募集资金已投入金额
智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	67,332.56	64,424.68	35,649.48	智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	44,135.96	43,382.55	35,649.48
				边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目		21,042.13 ¹	-
				“研发中心建设项目”节余募集资金			

注 1：新增募投项目拟使用募集资金投资总额为 31,845.54 万元，除上表中由“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”调减金额 21,042.13 万元投入外，还包含“研发中心建设项目”结项后节余资金 10,803.41 万元。

同时，公司本次拟将变更后的“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 6 月 30 日变更至 2026 年 6 月 30 日。

本项目涉及变更募集资金投向的总金额为 21,042.13 万元，变更用途金额占公司 2020 年非公开发行股票募集资金净额的比例为 28.27%。

（三）本次部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项履行的审议程序

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》，保荐机构发表了意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，本次部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项不构成关联交易。

二、募投项目结项的具体情况

（一）拟结项项目具体开展情况

公司首次公开发行募集资金投资项目之一“研发中心建设项目”的实施主体为公司及博通集成科技（深圳）有限公司。截至 2025 年 6 月 20 日，公司通过“研发中心建设项目”的实施，在深圳市南山区留仙大道创智云城完成了场地购置、建筑装修、研发软硬件设备购置及相关校准调试等研发中心建设的工作，同时公司借助该等研发中心积极开展了相关研发工作，成功完成了 BK2XXX 系列型号芯片的研发，该等芯片集成了低相位噪声压控振荡器（VCO）、发射功率放大器（PA）和双通道基于吉尔伯特单元的混频接收器等关键模块，可有效应用于人体感知和盲区检测。因此，经过公司的评估和验收，“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对该项目进行结项，该项目预计使用募集资金投资金额 24,437.19 万元，已投入募集资金 16,469.67 万元，实际节余募集资金 10,803.41 万元（包含募集资金现金管理及账户存储产生的利息收入等 2,835.89 万元）。本次节余募集资金金额占公司 2019 年首次公开发行股票募集资金净额的比例为 17.91%。

（二）拟结项的募投项目募集资金节余主要原因

1、由于该等项目的立项时间较早，实施周期较长，在募集资金投资项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎使用募集资金，通过公司近年来的研发积累加强公司内部研发资源的协同，综合考虑当前经济环境、设备供应渠道及价格波动情况，合理调整设备采购与使用方案，在各个环节积极控制、监督和管理成本费用；同时，公司严谨地开展研发

中心选址工作，控制不动产的购置成本，因此合理降低了项目总投资。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益；同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（三）募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的安排

为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将“研发中心建设项目”节余募集资金 10,803.41 万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）全部转入本次新增的募投项目“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”中。

三、募投项目变更与延期的具体情况

（一）拟变更及延期募投项目的具体开展情况

“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”是在公司无线通信产品技术布局的基础上，结合相关政策推动汽车预置安装 ETC 车载装置的契机，加快推进在智慧交通、智能驾驶领域的业务布局，开展实现相关产品整体解决方案的研发。项目实施主体为公司及公司全资子公司博通集成电路（浙江）有限公司。本项目原计划购置房屋及建设车规级芯片研发测试实验室，并购置相关的设备、软件及知识产权等，并配备经验丰富的研发团队以实施相关技术和产品的研发工作。截至 2025 年 6 月 20 日，该项目累计已投入募集资金金额、投入进度、尚未投入金额情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	预计募集资金投资总额	募集资金累计投入金额	募集资金投资进度	募集资金尚未投入金额
智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	67,332.56	64,424.68	35,649.48	55.34%	28,775.20

公司本次拟取消项目原计划的房屋购置，充分利用现有研发场地与设备，并相应调整投资结构，调减募集资金投资 21,042.13 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	投资构成	调整前投资总额	调整后投资总额	调整后募集资金投入金额
1	工程建设费用	29,470.00	7,914.38	7,914.38
1.1	物业购置	10,329.00	-	-
1.2	装修	3,756.00	-	-
1.3	设备及软件购置	15,385.00	7,914.38	7,914.38
1.3.1	硬件设备购置	8,135.00	1,658.45	1,658.45
1.3.2	软件购置	7,250.00	6,255.93	6,255.93
2	研发支出	30,942.50	29,756.36	29,756.36
2.1	研发人员工资	7,100.68	10,112.55	10,112.55
2.2	IP 技术	12,341.82	13,858.96	13,858.96
2.3	光罩	11,500.00	5,784.85	5,784.85
3	基本预备费	1,208.25	753.41	-
4	铺底流动资金	5,711.81	5,711.81	5,711.81
合计		67,332.56	44,135.96	43,382.55

自该项目启动后，公司已研发形成数款满足车规级应用的芯片，并完成了车规认证，成功进入全球品牌汽车供应链体系并实现了数百万片芯片的出货，项目已经取得阶段性成果。本次对该项目的投资结构进行调整，对达到预定可使用状态的时间进行延长，并未取消原募投项目，公司后续将继续推进项目投资，该项目下已形成的资产、技术和产品等不受影响。

（二）拟变更及延期募投项目的变更情况及原因

1、调减项目投资金额的原因

“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”是公司在 2020 年非公开发行股票时结合当时全球及国内汽车市场正处于复苏期，并且公司在 ETC 后装领域积累了充足的技术和产品储备，获得了良好的市场反馈等因素，经过充分论证后审慎确定将募集资金投向了智慧交通及智能驾驶领域。该项目原计划使用募集资金购置物业作为项目实施场所，但受宏观经济形势、相关产业政策变化等因素的影响，近期，公司综合考虑新建研发测试实验室的资金、时间成本，为更高效的使用募集资金，合理降低项目实施费用，公司决定取消项目原计划的房屋购置，充分利用公司现有场地、设备资源以及各业务项目之间的协同作用，增加研发人员薪资及 IP 技术等知识产权投入的方式对项目投资结构进行调整，以使公司的投入符合当下市场环境及公司实际情况，顺利推进项目的实施。

同时，近年来随着 AI 技术的深入发展与广泛应用边缘 AI（端侧 AI）相关产品的优势日益凸显，需求逐渐扩大，而博通集成在低功耗无线 SoC 领域积累了深厚的设计与整合经验，恰好构成了发展高能效比的端侧 AI 芯片的坚实基础。过去在汽车电子领域的投入，是基于当时的产业周期和公司在汽车电子领域的既有优势，而如今高性能、低功耗、高安全性的边缘 AI 芯片在智能家居、智能穿戴、工业物联网、智能安防等领域需求正在呈现爆发式增长。

因此，结合市场发展趋势、公司实际情况及募集资金使用情况，经审慎研究，公司调整“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”的投资结构，并将调减的募集资金金额投入“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”。

2、项目建设计划延期的原因

“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”对应的产品主要为车规级芯片，相对于普通消费级芯片，车规芯片由于应用场景的环境复杂，对于芯片本身的稳定性、可靠性、耐久性要求更高，产品研发过程中需要 Tier 1 和主机厂的配合和支持，此外芯片研发完成后，还需通过下游客户的严格测试和验证，之后才能进入客户导入和量产阶段。与此同时，近年来全球汽车产业的发展面临新的机遇与挑战，特别是 AI 和自动驾驶等技术的发展，对于芯片硬件底层功能和上层应用算法提出了更高要求。公司项目在研发推进过程中，也需兼顾市场动态、客户需求和前沿技术趋势等多方面的变化，持续对车规芯片产品的技术指标和性能参数进行迭代升级，相关的项目投入仍在持续进行中。因此，在调整投资结构的基础上，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 6 月 30 日。

四、新增募投项目的具体情况

（一）项目基本情况

公司本次拟新增募投项目为“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”，项目实施主体为公司、公司全资子公司博通集成科技（深圳）有限公司和上海安赛奥微电子有限公司，实施地点为中国（上海）自由贸易试验区张东路 1387 号 41 幢及深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城 1 标段 1 栋 C 座 32 层。

本项目聚焦低功耗、高性能且安全的端侧 AI 芯片及解决方案研发，面向智

能家居、穿戴设备和汽车电子等领域，构建完整技术体系和产品谱系。在硬件层面，研发异构计算 SoC，集成支持稀疏化与混合精度计算的自研 NPU，并结合第三方 IP 优化性能，为各领域应用提供硬件支撑。在算法层面开展硬件感知的神经网络架构搜索，结合模型量化及剪枝技术，实现高效运行。在软件层面，开发基于 LLVM 的统一编译器与 SDK，实现异构处理器间 AI 应用无缝调度，降低开发门槛。在安全方面集成硬件安全模块或可信执行环境，保障全链路数据与模型安全，为关键场景提供安全保障。

本项目实施将增强公司边缘端 AI 技术能力，通过加速实现低功耗高性能芯片及解决方案落地，推动公司产品从解决设备连接问题的“功能芯片”到解决设备智能问题的“平台级 SoC”的转型，进一步提升产品附加值及技术壁垒，增强在智能家居、穿戴设备及汽车电子等领域的市场竞争力。

（二）项目投资情况

本项目计划总投资 45,828.56 万元，拟使用募集资金投入 31,845.54 万元，项目建设周期为 3 年，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额
1	工程建设费用	11,087.00
1.1	硬件设备购置	2,687.00
1.2	软件购置	8,400.00
2	研发支出	33,842.96
2.1	研发人员工资	19,782.96
2.2	测试认证费	360.00
2.3	光罩	7,050.00
2.4	IP 技术	5,900.00
2.5	其他研发费用	750.00
3	基本预备费	898.60
合计		45,828.56

（三）项目可行性及必要性分析

1、项目背景

在科技飞速发展的当下，AI 技术的不断成熟，随之几乎所有的 IoT 设备均可以加入 AI 技术提升表现能力，如 AI 耳机、AI 眼镜等 AIoT 终端形态频出。未

来，伴随数据价值的不断挖掘、更高层次的智能化需求的增长，以及多模态 AI 大模型技术与端云协同架构的成熟，AIoT 将向更高阶的智能化演进，促进更复杂及更智能应用场景的实现，进一步扩大 AIoT 的市场潜力。

AI 技术的高速发展也带来了云端 AI 的可靠性与安全性不足、应用效果不达预期等问题，而在此背景下端侧 AI 具有的隐私和安全、低延时、可靠性、低成本等优势使得端侧部署逐渐成为“AI+”落地的有效路径。而在该等需求下引发的端侧 AI 的快速发展，标志着 AI 产业正经历从“云端集中式计算”向“终端分布式智能”的重要转型。这一演进既是行业技术迭代的必然结果，也是智能终端应用场景拓展等产业需求驱动下的生态革新。

2、项目必要性分析

（1）拓展研发资源投入，推动业务升级

公司成立以来始终专注于无线通信 SoC 芯片，其产品主要解决设备的连接和通信问题，应用于各类 AIoT 设备中。随着万物智联时代的到来，AIoT 领域不断涌现新型应用，场景持续升级。终端需求层面，消费者对物联网设备提出更高要求。例如，智能家居需根据用户习惯自动调节设备，智能手表需在数据传输基础上实现健康监测数据分析。除通信功能外，这需要 AIoT 设备具备更高的智能分析、决策能力和更高效的算力水平。

在此背景下，公司拟将依托在 AI 无线通信的经验和技术积累，将研发资源拓展至端侧 AI 算力。本项目将通过对异构计算 SoC、硬件感知的神经网络架构搜索（NAS）与先进模型量化及剪枝技术的研究、基于 LLVM 的统一编译器和 SDK 的开发，以及硬件安全模块的集成等，构建一个集硬件、算法、软件和安全于一体的端侧 AI 计算平台，从而满足 AIoT 设备对 AI 算力的需求。

本项目的建设是公司研发资源配置与业务发展战略的根本性转型，是对边缘端 AI 设备产业智能化升级趋势的主动响应，能够增强公司在端侧 AI 芯片市场的核心竞争力。此外，本项目中整合了业界领先的 IP，并构建了完整的开发工具链，能够拓展公司与 IP 供应商、AI 算法公司等产业厂商的合作深度，推动公司业务向综合性 AI 平台赋能服务升级，为公司开辟新的增长曲线与市场空间。

（2）顺应行业发展趋势，助力端侧 AI 发展

随着 AI 技术向终端场景的快速渗透，端侧 AI 因低延迟、高隐私性及网络独立性，成为智能设备升级的核心驱动力。然而，当前端侧 AI 部署面临多重挑战。比如，通用芯片已经难以满足 AI 计算的高并发与低功耗需求、软硬件之间缺乏统一调度框架，导致资源利用率低下、未来端侧模型参数量不断提升，各芯片厂商均需加大力度提升 AI 算力性能。因此，构建软硬件和算法深度协同的端侧 AI 解决方案，成为了释放边缘端设备智能潜力的关键路径以及企业抢占边缘端 AI 设备时代市场地位的核心战略。

为了顺应行业发展趋势，本项目将从以下几个方向进行技术研发和布局。首先，在硬件层面，本项目将进行异构计算 SoC 的研发设计，并集成能够支持稀疏化与混合精度计算的自研 NPU，可以显著降低产品功耗和内存占用。其次，在算法层面，本项目将重点研究硬件感知的神经网络架构搜索（NAS）与先进的模型量化及剪枝技术，以实现极致的运行效率。同时，为驱动硬件，本项目将在软件层面开发一套基于 LLVM 的统一编译器和软件开发包（SDK），解决异构硬件协同效率低、开发者适配成本高的问题。此外，本项目还将集成硬件安全模块（HSM）或可信执行环境（TEE），以应对端侧 AI 场景的数据泄露与模型篡改风险。本项目的建设通过提供全栈式端侧 AI 解决方案，将有效推动行业在高性能低功耗 AI 芯片、软硬件协同工具链等领域的发展，为智能家居、智能穿戴和智能汽车等场景提供核心技术支撑。

3、项目可行性分析

（1）持续稳定的国家政策为本项目建设筑牢根基

集成电路作为现代信息技术产业的硬件基础，是促进经济发展和保障社会稳定的基础性、战略性产业。我国已制定了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《国家集成电路产业发展推进纲要》等一系列鼓励创新的政策，从多个方面推动集成电路产业的发展。此外，工信部在《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》中也明确提出，要进一步深化移动物联网与人工智能、大数据等技术融合，加快技术创新和产业化。

（2）专业的研发团队为本项目建设提供了有效保障

在人才建设方面，公司持续引进高端技术人才，增强研发实力。截至 2024 年底，公司研发人员总数为 244 人，占公司总人数的比例高达 86.52%。公司核心团队主要来自国内外顶尖高校和科研机构，且在集成电路工业界积累有数十年丰富的管理经验和先进技术，具备深厚的低功耗射频收发器设计经验、高效率电源管理和 SoC 架构经验、RF-CMOS 设计能力以及先进数字信号处理与 AI 技术集成经验。同时，公司还建立了完善的绩效考核体系，实行有竞争力的薪酬激励政策，鼓励团队积极创新，提升团队工作效率。

（3）深厚的技术积累为项目顺利实施奠定了稳固基础

公司自成立以来，一直重视研发投入及技术创新。2024 年度，公司研发费用占当期收入比例高达 32.99%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有中国、美国发明专利授权共 158 项，形成了显著的技术壁垒。通过坚持不懈的自主研发，公司已经形成了基于物联网领域需求的丰厚技术储备和产品谱系，尤其在近日举办的产品发布会上，公司发布了新一代低功耗、高性能芯片产品矩阵，其中 BK7259 作为 AIoT 算力标杆，率先集成 ARM Ethos-U65 microNPU 的 Wi-Fi 6 MCU，为边缘智能应用注入超强算力与卓越能效；BK7239N 充分释放双频 Wi-Fi 6 的巨大潜能 5.8GHz 接收仅 15mW 功耗，轻松应对复杂网络环境，确保流畅双频体验；BK7236N 则凭借低至 13mW 的射频接收机功耗，赋能长效物联网应用。

（4）完善的研发和质量制度和稳定的客户关系为本项目建设提供保障

多年以来，公司已形成高度规范化的研发流程和质量控制体系，并根据实际执行情况进行不断地完善和更新。公司的研发中心按设计专业下设七大部门，各个研发部门之间分工明确，相互协作，全面覆盖产品开发全流程。同时，公司高度重视产品质量与客户服务质量，并制定了严格的质量控制体系，保障公司产品从设计研发到量产交付的全生命周期质量可控。凭借高品质的产品质量以及丰富的行业经验，公司积累了诸多稳定的客户群体并树立了良好的品牌形象。

五、新增募投项目可能存在的风险及公司应对措施

（一）研发成果未达预期的风险

“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”主要建设一个集硬件、算法、软件和安全为一体的端侧 AI 解决方案。投资项目的顺利实施将有效增强公司产品技术水平及核心竞争力，有助于强化公司整体竞争优势，增强抗风险能力，是保障公司业务可持续发展的重要举措。尽管公司已对募集资金投资项目进行了充分的可行性研究和论证，但如未来公司在研项目研发进度不及预期，或新技术、新产品研发失败，则公司前期研发投入将无法收回，同时将对公司推出新产品造成不利影响，对整体经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将紧密关注产业发展动态，做好相应的风险预警措施，适时、灵活进行研发计划的调整。

（二）商业化进展不及预期的风险

本募投项目的投入需要公司管理层和研发人员具备对端侧 AI 技术、下游终端应用领域以及集成电路产业未来发展趋势的深刻洞察与精准预判能力。若公司对产业发展趋势与理解判断出现严重偏差，将导致公司技术成果与现实环境脱节，无法有效满足客户需求，从而影响研发成果转化和商业化进展。

应对措施：公司将持续关注行业技术发展，加大在技术上的投入，增强公司对前沿技术的研究能力。此外，公司将通过申请专利、技术保密等方式保护核心技术，防止出现技术被仿制、泄露等情况发生。

六、本次募投项目变更后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司拟将本次结项节余的募集资金从原募集资金专户转入 2020 年非公开发行股票项目所开立的募集资金专户中，后续公司将与募集资金开户银行、公司保荐人签订募集资金专户存储多方监管协议，并严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，规范使用募集资金。

七、相关审议程序

本次部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，该等事项尚需提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

公司本次部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，相关调整符合公司实际发展情况，有利于提高募集资金使用效率，不影响前期保荐意见的合理性。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对公司本次部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

李林强

李林强

何朝丹

何朝丹



天风证券股份有限公司

2025 年 6 月 30 日